

工程時間短縮

狭ギャップ/ピッチ充填

低反り

用途

半導体パッケージ/モバイル

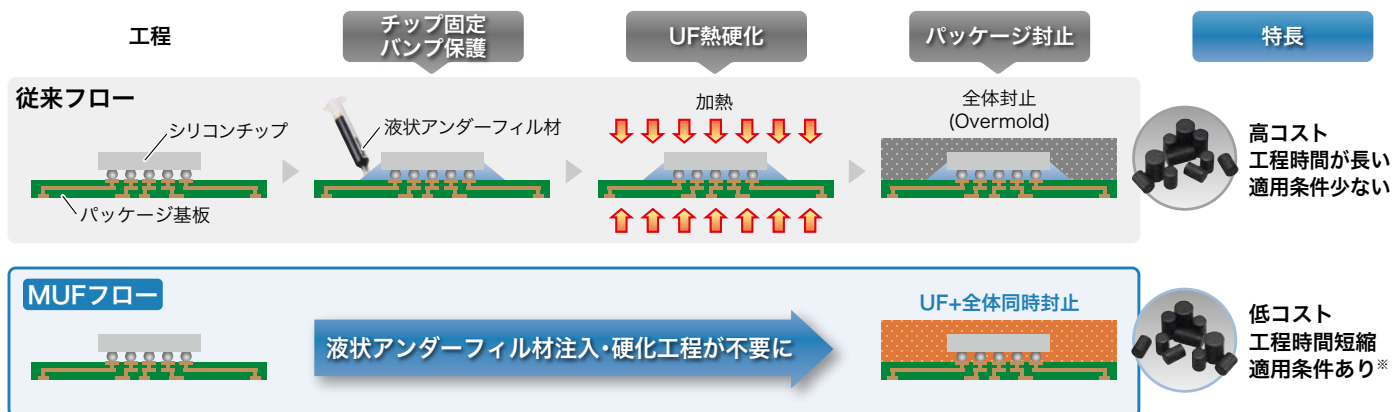
最先端半導体パッケージ (FC-CSP、FC-SiPモジュールなどのフリップチップパッケージ)

CV8710 CV8713

モールドアンダーフィル対応半導体封止材

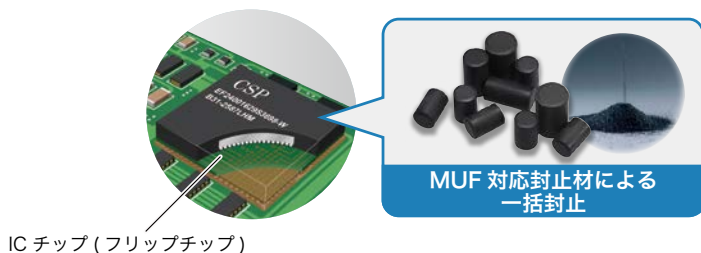
モールドアンダーフィル (MUF) 材により、フリップチップ下の狭ギャップ充填と全体封止をボイドレスで一括成形。独自のファインフィラー高充填設計技術・樹脂設計技術により、最適な熱収縮を実現し、パッケージの低反り化に貢献。

プロセス比較



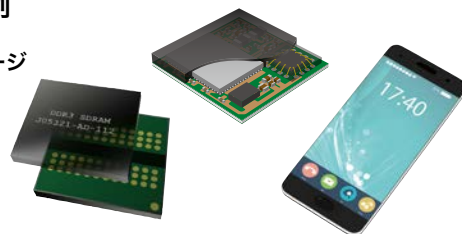
※パッケージ構造 (チップサイズ・ギャップサイズ・バンブピッチなど) に起因

狭ギャップ・狭ピッチ充填対応可能



対応パッケージ例

フリップチップパッケージ
・FC-CSP
・FC-SiP モジュール
ほか



他にも様々なラインアップがあります。
お問合せください。

一般特性

項目	単位	LEXCM ^{CF} CV8710TAC	LEXCM ^{CF} CV8710TLC	LEXCM ^{CF} CV8710U	LEXCM ^{CF} CV8715BU	LEXCM ^{CF} X8710U-F1	LEXCM ^{CF} CV8713
EMCタイプ	—	Green	Green	Green	Green	Green	Green
フィラーカットポイント	μm	30		20		10	20
曲げ弾性率 (R.T.)	GPa	24	20	25	12	25	25
ガラス転移温度 T _g (TMA)	°C	135	150	143	140	156	145
熱膨張係数 (α _l)	ppm/°C	10	13	10	21	10	10
成形収縮率	%	0.20	0.30	0.21	0.55	0.19	0.20

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

特性値はラインアップ中の一例であり、詳細はお問合せください。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

パナソニック インダストリー株式会社 電子材料事業部

© Panasonic Industry Co., Ltd. 202212